

ソフトウェアプロダクトライン国際会議(SPLC)2013 スポンサー募集案内

多品種システムの開発において、成果物再利用を実現するソフトウェアプロダクトライン(SPL)の活用が進んでいます。SPLCは、SPLに関する最も重要な国際会議の一つであり、プロダクトラインに関する事例、技術、管理・組織論などについての第一線の情報入手や議論の場です。近年は組込み分野だけでなく、エンタープライズ系を含めた様々な分野での、再利用にかかわる多様な話題が扱われています。

特に本会議は産業界からの参加者が約半数を占め、実務的な視点が強い点に大きな特徴があります。またSPLに関心を持つ一線の技術者や管理者が集う場であり、この分野に関する情報発信の場として有効に活用することができます。

来る2013年8月には第17回となるSPLC2013を東京で開催予定です。SPLに関わる企業・団体の皆様には、厳しい経済情勢の中ではございますが、SPLCの趣旨にぜひご賛同の上、開催にご協力を賜りますようお願い申し上げます。

スポンサー要領

企業・団体の皆様に、以下のいずれかの形でご協力頂けると幸いです。

プラチナ (50万円):

- 本会議開会および閉会でのスポンサー紹介
- 会議プログラム、Webページ、予稿集、横断幕、告知チラシへのロゴ表示
- 会議プログラムへのスポンサー広告掲載(1頁)
- 参加者用カンファレンスバッグへのチラシ同封(A4サイズ2枚)
- スポンサー横断幕の掲示(最大1.5平米メートル)
- SPLC2013本会議への無料参加券3枚
- 展示ブース(2m×2.5m)

ゴールド (35万円):

- 会議プログラム、Webページ、予稿集、横断幕、告知チラシへのロゴ表示
- 会議プログラムへのスポンサー広告掲載(半頁)
- 参加者用カンファレンスバッグへのチラシ同封(A4サイズ1枚)
- スポンサー横断幕の掲示(最大1.0平米メートル)
- SPLC2013本会議への無料参加券2枚
- 展示ブース(2m×2.5m)

シルバー (20万円):

- 会議プログラム、Webページ、予稿集、横断幕へのロゴ表示
- 参加者用カンファレンスバッグへのチラシ同封(A4サイズ1枚)
- SPLC2013本会議への無料参加券1枚
- 追加料金での展示ブース(2m×2.5m)

ブロンズ (10万円):

- 会議プログラム、Webページ、予稿集、横断幕へのロゴ表示
- 追加料金での展示ブース(2m×2.5m)

上記形式以外での協賛についても歓迎いたします。詳細については下記問合せ先までご連絡ください。

問合せ先: 吉村健太郎(日立) kentaro.yoshimura.jr@hitachi.com